

ソフトウエアエンジニアリング株式会社



フィールドソリューション部 パーツ･リペア プロダクトマーケティング

＜業務のやりがい＞半導体製造装置メーカーとして、装置開発は重要であり、その装置を

募集職種

人材紹介会社
ソフトウエアエンジニアリング株式会社

採用企業名
半導体装置アフターマーケット

求人ID
1610011

部署名
フィールドソリューション部 パーツ･リペア プロダクトマーケティング

業種
電気・電子・半導体

会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数)

雇用形態
正社員

勤務地
東京都 23区

給与
650万円 ~ 1000万円

ボーナス
給与： ボーナス込み

勤務時間
フレックスタイム制 (コア11:00 ~ 16:00、標準9:00 ~ 17:30、休憩60分)

休日・休暇
年間休日122日 (2024年)、完全週休2日・祝日。有給12 ~ 20日、年末年始・特別休暇等

更新日
2026年11月10日 01:00

応募必要条件

職務経験
3年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ビジネス会話レベル

その他言語
中国語： 北京語 - ビジネス会話レベル

職種 / 募集ポジション フィールドソリューション部 パーツ･リペア プロダクトマーケティング求人タイトル -雇用形態 正社員契

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可は必要ありません

募集要項

ポジション：フィールドソリューション部 パーツ･リペア プロダクトマーケティング 仕事内容：半導体製造装置のパーツ・リペア商品の企画を行い、工場やサプライヤーと連携して世界市場向けの事業拡大戦略を推進します。

会社説明

新たな成長フェーズに入った半導体製造装置市場売上高2兆4,315億円、営業利益6,973億円（28.7%）（2025年3月期）「企業の成長は人、社員は価値創出の源泉」、チャレンジできる機会と公正な評価、風通しの良い職場